

JDB780H 聚氨酯灌封密封胶

产品描述

JDB780H是一种双组份，可室温或加热固化的聚氨酯灌封材料，适合电子电器的封装密封。固化后具有高强度、高韧性，抵抗湿气和其它大气组分，无溶剂、无固化产物，在-40~125℃间稳定的机械和电气性能。

产品特性

- 抵抗湿气，污物和其它大气组分；
- 无溶剂，无固化副产物，容易修补；
- 减轻机械、热冲击和震动引起的机械应力和张力；
- 在-40~125℃间稳定的机械和电气性能；
- 阻燃性能优异，完全符合欧盟ROHS指令要求。

产品用途

用于电子、电器、汽车等领域的封装应用。

主要性能

项目		典型值		测试标准
混合前物性 (23±2℃/50±5%RH)				
组分	--	A	B	--
外观	--	黑色流体	棕色流体	--
粘度 (Brookfield DV2T 6#转子, 转速 60r/min)	MPa·s	5000~7000	50~200	GB/T 2794-2013
比重	g/cm ³	1.45~1.50	1.20~1.25	GB/T 533-2008
混合后物性 (23±2℃/50±5%RH)				
重量比混合	--	A:B=6:1		GB/T 533-2008
比重	g/cm ³	1.45~1.55		GB/T 533-2008
粘度 (Brookfield DV2T 6#转子, 转速 60r/min)	MPa·s	1300~3000		B/T 2794-2013
可操作时间 (25℃)	min	15~35		B/T 13477.5-2002
完全固化时间 (25℃)	h	6~24		B/T 13477.5-2002
完全固化时间 (65℃)	h	1~2		B/T 13477.5-2002
固化后性能 (23±2℃/50±5%RH×24hours)				

硬度	Shore A	85±10	GB/T 531.1—2008
导热系数	W/m·K	0.8±0.1	ISO22007-2
膨胀系数	10 ⁻⁶ /K-1	<300	ISO11359-2:1999
剪切强度	MPa	≥2.0	GB/T 528—2009
拉伸强度	MPa	≥2.0	GB/T 528—2009
介电强度	kV/mm	17	GB/T 1408.1—2006
介电常数(60HZ)	--	≤4.0	GB/T 1409—2006
体积电阻率	Ω·cm	≥0.8×10 ¹⁴	GB/T 1410—2006
介电损耗(60HZ)	--	0.02	GB/T 1409—2006
吸水率(24h, 25℃)	%	<0.1	GB/T 8810-2005
工作温度	℃	-40~125	—

使用说明

- 使用前必须确保室内湿度在70%RH以下，在此之前请勿打开包装。
- 混合前，必须先把B组分搅拌均匀，再按A:B=6:1质量比例进行配比，当混合时，必须注意不要导入过多的空气，建议使用自动混合设备不仅可以按正确比例精准混合树脂和固化剂，而且不会导入空气。
- 如果不使用，A组分和B组分的容器必须在任何时候都保证处于密封状态，以防止吸入潮气。
- 长时间存放后，胶中的填料会有所沉降。请搅拌均匀后使用，不充分的混合会导致树脂性能不稳定或不完整。
- 为了降低混合物的粘度以便于后续灌封，可在混合前将A组份加热到50℃。若在5-10mbar的真空度下将混合物脱泡后再进行灌封使用，可以达到更加优良的力学及电性能。
- 烘烤温度：60±5℃下烘烤，烘烤时间：1小时以上。

注意事项

- 使用前，请详细查阅MSDS。远离儿童存放。
- 建议在通风良好的场所内使用。
- 使用时避免直接接触，应使用手套等保护设备，若不慎粘到皮肤上，须马上用肥皂水清洗。若不慎粘到眼睛上，须先用大量的水清洗并到医院检查。
- 仅限工业用途，详情请参考MSDS。

包装规格

- 30kg/套（A组分：25kg/桶；B组分：5kg/桶）。

储存及运输

- 远离儿童存放，保持A、B组分避光和避热，并且密封保存。
- 存放于干燥、阴凉处，避免太阳直晒，温度在5~30℃范围，相对湿度在40%RH以下，产品自生产之日起保质期为6个月。
- 本产品为非危险品，按一般化学品贮存、运输。